



kingston.com/emcp

eMCP

La solución de almacenamiento integrada perfecta y eficiente en el consumo de energía para aplicaciones móviles, IoT e integradas con limitaciones de espacio

Kingston ofrece una gama de componentes eMCP estándar JEDEC. eMCP integra almacenamiento de MultiMediaCard integrada (eMMC) y DRAM de doble velocidad de datos de bajo consumo (LPDDR) en un Paquete Multi-Chip (MCP) con un tamaño reducido. Esta solución proporciona una mayor integración, reduciendo el tamaño total. eMCP es un componente combinado ideal de almacenamiento y memoria para sistemas con limitaciones de espacio, como Smartphones, tabletas, dispositivos portátiles y varios dispositivos "Internet de las cosas" (IoT).

BENEFICIOS FUNDAMENTALES

- Solución flash NAND controlada que simplifica el diseño y el mantenimiento del producto con una interfaz eMMC estándar de la industria. Esto reduce significativamente la complejidad del diseño y el ciclo de calificación.
- La combinación altamente integrada de memoria y almacenamiento reduce el espacio en el diseño del sistema, lo que convierte a eMCP en una solución ideal para aplicaciones de factor de forma pequeño.
- La DRAM de bajo consumo reduce el consumo general de energía, lo que convierte a eMCP en una solución óptima para muchas aplicaciones alimentadas por batería, como dispositivos portátiles y productos del IoT móviles.
- Reducción de la complejidad de la lista de materiales con disminución del número de componentes.
- Múltiples configuraciones de firmware disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de su aplicación en cuanto a rendimiento, potencia y vida útil.

SEGMENTOS DE MERCADO



Smartphones de Tabletas



Dispositivos portátiles



Aceleradores de IA



IoT

eMCP CÓDIGOS DE ARTÍCULO Y ESPECIFICACIONES

eMCP basado en LPDDR3

Código de artículo	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperaturas de operación
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C a +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C a +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C a +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C a +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C a +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C a +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C a +85°C

eMCP basado en LPDDR4x

Código de artículo	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperaturas de operación
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	149	-25°C a +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C a +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C a +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C a +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C a +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.1	254	-25°C a +85°C

